

**关于通富微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3

关于通富微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA09948 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通富微电子股份有限公司（以下简称通富微电公司）截至 2020 年 10 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对通富微电公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的截至 2020 年 10 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供通富微电公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年十一月二十四日

通富微电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1488号）核准，向35名投资者非公开发行人民币普通股（A股）175,332,356股（每股面值1元），每股发行价为人民币18.66元，募集资金总额为人民币3,271,701,762.96元。扣除与本次发行有关费用人民币26,352,779.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,245,348,983.29元。

截至2020年10月28日止，本公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币3,247,808,148.86元。上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字(2020)第110ZC00405号验资报告。

二、非公开发行股票预案（修订案）中对募集资金投向承诺情况

根据本公司有关2020年度非公开发行股票的相关决议，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金计划投资总额
集成电路封装测试二期工程	145,000.00
车载品智能封装测试中心建设	103,000.00
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00
补充流动资金及偿还银行贷款	102,000.00

其中，车载品智能封装测试中心建设项目的实施主体为本公司，集成电路封装测试二期工程项目的实施主体为本公司的子公司南通通富微电子有限公司（以下简称南通通富），高性能中央处理器等集成电路封装测试项目的实施主体为本公司的子公司苏州通富超威半导体有限公司（以下简称通富超威苏州）。本公司将通过向南通通富现金增资以及借款方式、向通富超威苏州借款的方式具体组织实施。

在本次非公开发行股份募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况，以自筹资金方式先行投入。本次非公开发行募集资金到位后，再予以置换。

根据本公司于2020年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,245,348,983.29元，少于拟使用募集资金投资额人民币400,000.00万元。根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司拟对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	原拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
集成电路封装测试二期工程	145,000.00	76,020.00
车载品智能封装测试中心建设	103,000.00	103,000.00
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00	50,000.00
补充流动资金及偿还银行贷款	102,000.00	95,514.90
合计	400,000.00	324,534.90

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年10月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为481,947,553.19元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
集成电路封装测试二期工程	299,765,472.76	2020年2月至2020年10月
车载品智能封装测试中心建设	3,875,238.46	2020年2月至2020年10月
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	178,306,841.97	2020年2月至2020年10月
合计	481,947,553.19	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与调整后投资承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	调整后承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
------	-----------	----------	------

集成电路封装测试二期工程	76,020.00	29,976.55	项目投建中
车载品智能封装测试中心建设	103,000.00	387.52	项目投建中
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00	17,830.68	项目投建中
合计	229,020.00	48,194.76	

五、其他事项

除自筹资金预先投入募集资金投资项目以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括本公司已用自筹资金支付的其他发行费用，截至 2020 年 10 月 31 日止，本公司已用自筹资金支付其他发行费用人民币 100.00 万元，本次拟一并置换。

通富微电子股份有限公司

董事会

2020年11月24日